3D 列印鑰匙圈名牌

林金旺 20220315

使用軟體:AutoCAD2020



找到 AutoCAD2020 軟體並開啟它。

開始	
	啟動圖面
田様板	•
┢田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	

本單元範例以簡單 3D 應用為主,不同時解說太多繪圖技巧和指令,亦不考慮其他設定,所以直接點選開始即可,如上圖。

繪製一 60x20 的矩形; 指令:rec 或以滑鼠點選矩形指令圖示,如下圖。 以滑鼠左鍵任意指定第一個角點 指定其他角點或 [面積(A)/尺寸(D)/旋轉(R)]: @60,20



繪製一直徑為3的圓形,這個圓形最後將會成為掛鑰匙環或綁吊線的孔; 指令:c

指定圓的中心點(移動滑鼠到矩形的右下角點後點按左鍵確定圓心位置) 指定圓的半徑或 [直徑(D)]: 1.5



移動圓型到適當位置。



指令: M, 也可點選移動指令圖示, 如下圖。



選取物件:以滑鼠點選圓 選取物件:按右鍵表示已選完物件 指定基準點或:點選圓心 指定第二點或 <使用第一點做為位移>:@-6,10

指令: C 指定圓的中心點或:以滑鼠點選圓心 指定圓的半徑或 [直徑(D)] <1.5000>: 6

畫作圖線 指令:_line 指定第一點:以滑鼠點選圓心 指定下一點或 [退回(U)]:@10<45 按空白鍵重複上一指令或再輸入指令:L 指定第一點:以滑鼠點選圓心 指定下一點或 [退回(U)]:@10<-45

複製兩條線作為圓切線

指令: CO

分別複製兩線道圓相切位置,如下圖。



將兩作圖線刪除

指令: e



剪除多餘線條

指令:t

按 Enter 鍵兩下

將沒用到的線條切除,最後如果有無法切除的線可用 Erase 指令刪除,如上圖。



將所有線條連結成聚合線(Polyline) 指令:J



指令: F

FILLET

選取第一個物件或 [退回(U)/聚合線(P)/半徑(R)/修剪(T)/多重(M)]: R 請指定圓角半徑 <0.0000>: 6 點選命令列上**聚合線(P)**,或直接輸入 P

點選先前繪製的框線即可將所有尖角編輯成半徑 6 的圓角,如上圖。



偏移外框線,在內側做一等距框線,如上圖。 指令:o 指定偏移距離或 [通過(T)/刪除(E)/圖層(L)] <通過>:3 選取要偏移的物件或 [結束(E)/退回(U)] <結束>: 指定要在那一側偏移的點或 [結束(E)/多重(M)/退回(U)] <結束>:點選圖形內側 選取要偏移的物件或 [結束(E)/退回(U)] <結束>:*取消*

在內部做文字 指令: DTEXT 指定高度 <2.5000>:8 指定文字的旋轉角度 <0>:按 Enter 輸入文字(本範例針對初學者,暫不要用中文)



移動文字到適當位置

指令: M

MOVE

選取物件: 框選剛才輸入的文字

指定基準點或 [位移(D)] <位移>:滑鼠在文字上任點一點作為移動的基準點 指定第二點或 <使用第一點做為位移>:拉到適當位置後點一下滑鼠左鍵

將文字炸開成聚合線,以利後續編輯 指令: TXTEXP 正在初始化... Select text to be EXPLODED: 選取物件:點選文字 再將文字炸開成線段,以利後續編輯

指令: X

EXPLODE

選取物件:用滑鼠框選所有文字

將文字內多餘的線條刪除

*選擇欲刪除的線條,可以使用由右下往左上框選,或用 F 碰觸選取。

將顏色統一與其他同圖層物件相同

指令: CHPROP

選取物件:用滑鼠框選所有文字

輸入要變更的性質 [顏色(C)/圖層(LA)/線型(LT)/線型比例(S)/線粗(LW)/厚度(T)/透明度(TR)/材料(M)/可註解(A)]: c

新顏色 [全彩(T)/顏色表(CO)] <139>: bylayer

按 Enter



切換到 3D 塑型的工作區。



切換到等角視角



指令: EXTRUDE 目前的線架構密度: ISOLINES = 4,封閉輪廓的建立模式 = 實體 選取要擠出的物件或 [模式(MO)]:點選外輪廓線 選取要擠出的物件或 [模式(MO)]:點選內部小圓 選取要擠出的物件或 [模式(MO)]:按滑鼠右鍵或 Enter 完成選取 指定擠出高度或 [方向(D)/路徑(P)/推拔角度(T)/表示式(E)] <3.0000>: 2.5



將文字和內側平面上移至2的高度 指令:M 選取物件:選取文字和內側平面 指定第一點:任點一點 指定第二點或 <使用第一點做為位移>:@0,0,2 指令:Enter

將文字和內側平面擠出成為厚度 0.5 的實體。

指令: extrude 目前的線架構密度: ISOLINES = 4,封閉輪廓的建立模式 = 實體 選取要擠出的物件或 [模式(MO)]:_MO 封閉輪廓建立模式 [實體(SO)/曲面(SU)] < 實體>:_SO 選取要擠出的物件或 [模式(MO)]: p 找到 11 個 選取要擠出的物件或 [模式(MO)]: 指定擠出高度或 [方向(D)/路徑(P)/推拔角度(T)/表示式(E)] <2.5000>: 0.5



利用差集减去前面步驟將輪廓向內平移形成的內側區塊。

指令:_subtract 選取要從中減去的實體、曲面或面域 ..

選取物件: 點選主體(例如外輪廓線)

選取物件:

選取要減去的實體、曲面和面域 ..

選取物件: 點選內側區塊



製作圓角

指令: FILLETEDGE 或點選上圖中所示的命令圖示。 半徑 = 1.0000 選取邊緣或 [鏈(C)/迴路(L)/半徑(R)]: 點選**半徑(R)**或輸入 r 輸入圓角半徑或 [表示式(E)] <1.0000>: 0.5 選取邊緣或 [鏈(C)/迴路(L)/半徑(R)]: 點選鏈(C)或輸入 C 選取邊鏈或 [邊(E)/半徑(R)]: 點選內側平面擠出的上邊緣 選取邊鏈或 [邊(E)/半徑(R)]: 已選取要圓角的 10 個邊。 按 Enter 接受圓角或 [半徑(R)]: 指令: 按 Enter

```
指令:_FILLETEDGE
```

```
半徑 = 0.5000
```

選取邊緣或 [鏈(C)/迴路(L)/半徑(R)]: r

輸入圓角半徑或 [表示式(E)] <0.5000>:1

選取邊緣或 [鏈(C)/迴路(L)/半徑(R)]: 點選鏈(C)或輸入 C

選取邊鏈或 [邊(E)/半徑(R)]:點選本體上方外輪廓線

選取邊鏈或 [邊(E)/半徑(R)]:點選本體下方外輪廓線

按 Enter 接受圓角或 [半徑(R)]:按 Enter

[-][自訂視圖][2D 線架構]		
	自訂視覺型式	>
	2D 線架構	
	概念	
	擬真	
	講覧	
	帶邊的描影	
	灰色的深浅度	

切換到擬真顯示並旋轉角度可以看得更清楚,看完沒問題再切換回 2D 線架構顯示,以利後續編輯。

指令:_vscurrent

輸入選項 [2D 線架構(2)/線架構(W)/隱藏(H)/擬真(R)/概念(C)/描影(S)/帶邊的描影 (E)/灰色的深淺度(G)/手繪(SK)/X 射線(X)/其他(O)] <隱藏>:_r 指令:*取消*

此時可能會發現到文字和內圓角並沒有和預期一樣,因為前面省略了詳細說明; 在此補充三點:

1. 依前幾步驟方式編輯直徑 3 的內圓上下兩邊圓角

2. 將文字和本體以聯集的方式結合成為一體

3. 將文字中的內部封閉區塊以差集去除,例如字母 e 和 a



再切換到擬真顯示並旋轉角度以檢查是否仍有待修改,在這裡我把圓孔上、下也 做了半徑為1的圓角。



將 3D 物件匯出

選擇存檔位置及檔名;副檔名 stl 不用改。



選取實體或無縫網面: 選取整個物件



3D 列印後的成果